

采购需求

一、 货物需求一览表

包号	货物名称	数量	交货期	指定到货港	项目现场 (交货地点)
1	FPGA 芯片	1800 颗	见具体技术规格	无	买方指定地点

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、技术规格

（一）工作条件

此次采购的 FPGA 芯片（Field Programmable Gate Array）即现场可编程逻辑门阵列芯片，主要是为实现研究院自研超算中板级互联的功能。FPGA_sender 对所接受各通道数据进行处理、组装后通过高速收发 GTP IP 核串行发送到相邻 FPGA-receiver，FPGA_reciever 板解析出各通道数据后，再分发到相应的通道中。

（二）技术参数

1. *最大 I/O 引脚数 \geq 290 个；
2. *GTP 高速接口速率 \geq 3Gb/s, 数量 \geq 4 对；
3. 工作温度：0℃-85℃；
4. *芯片尺寸： \leq 23mmX23mm；
5. *封装形式：FGG484
6. 查找表（LUT）数 \geq 26000 个
7. 逻辑单元数 \geq 43000 个
8. 内存 \geq 2000Kb

（三）技术服务及验收

3.1 供应商提供的产品（含必要的零配件、工具、包装等）必须是全新的、表面及内部均无瑕疵的原厂正品，要求所有产品必须为 2022 年 3 月 30 日之后生产，如光罩因生产方的原因发生品质误差，供应商需与制造厂商确认解决方案并提供相应报价。

3.2 供应商需要提供每批产品的 COC 证书或者相关测试报告或质量保证书或验收合格证书及其他相关技术文件，确保产品满足合同约定的技术指标要求。

3.3 所有产品在交付之后，必须有 LOT 码，可追溯到原厂。

3.4 包装要求：原厂原包

3.5 采购方验收分为两个阶段，外观验收及技术指标验收。外观验收在产品到货后由双方共同开箱进行验收，若发现产品存在问题或与规定不符，采购方将拒绝接收。技术指标验收需要提供 foundry 测试参数报告以作证明。

（四）保修和售后服务

4.1 质量保证期为验收合格后 12 个月。保修和售后服务参考制造厂所能提供的保修及售后条例执行。该段时间内，若产品发生因供应商原因（除保修条例免责范围之外）造成的损坏和性能下降，采购方可根据达成的协议退回并更换。

4.2 由采购方指定承运方进行运输并进行保险，若于运送阶段发生产品破损，需由承运方按照保险相关条例向采购方进行赔付。

（五）交货时间与地点

5.1 交货时间：

2022 年 10 月 30 日前。

5.2 如供应商无正当理由迟延履行，采购方有权要求供应商支付误期赔偿金，误期赔偿金按交付货物的总价款 0.5%/周 计收，不足一周按一周计。误期赔偿金由采购方从货款中直接扣除。

5.3 交货地点：采购方指定地点